

## 慕尼黑上海电子展热点追踪：告别算力虚火，回归硬件原生

2026年春，汽车产业站上充满张力的十字路口。

一方面，我们见证历史时刻：2025年中国车企以近2700万辆的全球销量，首超日本，正式登顶世界第一（新华网援引日媒报道）。另一方面，荣耀背后的寒意却愈发刺骨。全球汽车市场增速趋缓，“应用层创新”红利期不再，智驾算法、智能座舱卷入同质化竞争泥潭，单纯的“功能堆料”已无法构建真正的护城河。

行业的博弈重心，正经历一场从“看得见的功能”向“看不见的基石”的范式转移。端到端大模型、兆瓦闪充、固态电池及飞行汽车等新技术新方向，正由愿景进入落地临界点。未来的第二增长曲线何在？纷繁复杂的技术路线中，谁是确定性更强的“优解”？

答案或能在2026慕尼黑上海电子展上找到。这里汇聚了上游半导体与电子领域近1800家海内外优质企业与本土创新力量，不仅是底层硬件革命的超级风向标，更是从业者在内卷时代重塑竞争优势的核心枢纽。观众预登记通道已开启！点此可注册观展：<https://dwz.cn/B1uXgnu9>

### AIEV：从算力堆砌到硬件原生的突围

亿欧智库数据显示，2025年中国AIEV渗透率已逼近20%大关，并将于2030年跨越50%的临界点。伴随端到端大模型加速上车，智驾竞争已不再单纯依赖算力峰值的堆砌，而是转向芯片等底层硬件的“原生适配能力”——即在极限单位功耗下，对算力密度与信号完整性的极致掌控。

2026慕尼黑上海电子展上，这种范式转移将具象化为可触摸的解决方案。德州仪器(展位号:N4.605)的AIEV新品TDA5高性能SoC系列打破了传统算力瓶颈，凭借10-1,200 TOPS的弹性扩展与功耗/安全双重优化，精准回应车企“软件定义汽车”（SDV）落地中的算力挑战；AWR2188 4D成像雷达收发器则重新定义了感知边界，以单芯片8TX/8RX架构实现更敏锐的环境洞察，为算法提供高信噪比的“原生数据”；而DP83TD555J-Q1以太网PHY更是打通了神经末梢，通过10BASE-T1S技术将高速网络延伸至边缘节点，在降低布线复杂度的同时确保了信号传输的完整性。

思特威(展位号:N4.513)则通过物理架构的革新，从源头确保视觉数据的纯净度与一致性，精准响应端到端大模型对高保真输入数据的极度渴求。其全新8.3MP高性能车规级CMOS图像传感器SC860AT，搭载多项专利技术，不仅以140dB的超高动态范围（HDR）突破了极端光照下的成像极限，更受益于创新的单像素架构设计，可以有效避免大小像素架构带来的光学串扰、色差问题，在提升感光度的同时显著降低噪声。

### 新能源动力爆发：兆瓦闪充与固态电池的物理防线

2026年，是能源技术落地的分水岭。新能源汽车的竞争主战场已从续航焦虑转向补能效率。比亚迪称“兆瓦闪充”技术峰值充电速度可达2公里/秒，充电5分钟续航增加超400公里；各大电池巨头纷纷加速全固态电池商业化进程，宁德时代代表态将于2026年推进中试，能量密度可达450Wh/kg，并计划2027年小批量生产。

当电压平台从800V跨越至1000V及以上，高压安全、热管理等成为悬在所有车企头上的达摩克利斯之剑，底层电子元件的稳定性将直接决定整车的安全上限。瑞能半导体(展位号:N5.536)2000V高压标准整流管WND60P20W和WND90P20W，专为应对1000VDC电动汽车充电基础设施的极端工况而生。这一系列产品可降低电压尖峰和杂散电感对组件寿命带来的风险，为新能源汽车快充提供强有力的支持，提升系统可靠性和功率密度。

在高压快充与高能量密度电池并行的2026年，热管理已不再是简单的散热，而是对能量流的精准调度。纳芯微(展位号:N4.621)的热管理控制器正是这一复杂调度的中枢，通过精准控制BDC、BLDC及双极步进等各类电机，实现对关键热管理器件（电动水泵、冷却剂阀和膨胀装置等）的操作，并通过CAN-FD与区域控制器相连，以实现电动汽车的电池、电驱动以及乘客舱等进行热管理。这不仅确保了极端工况下热量的高效疏导与均衡分布，更以芯片级的精准控制，为高压系统的安全运行筑起了一道动态响应的“温度防线”。

### 车路云一体化建设潮下的链接重塑

“车路云一体化”走出示范阶段，进入了规模化建设期。据国家智能网联汽车创新中心透露，《车路云一体化智能

路侧基础设施分级技术要求（城市道路）》正式标准有望于上半年发布。而2026年恰逢“车路云一体化”应用试点收官之年，各地密集推进，行业迎来建设高峰期。

智能网联及自动驾驶传感器增多、座舱交互复杂化等带来车载数据洪流，对更高速高频、高稳健性、高兼容性的连接需求迫切。TE Connectivity(展位号:W1.305)带来的GEMnet万兆级差分连接器则专为此需求而生。作为对接双绞线的解决方案，GEMnet连接器支持万兆位级别的数据传输，可为汽车行业提供15GHz和高达56Gbps性能的高频高速连接。GEMnet自身同时支持车载以太网100/1000BASE-T1、2.5/5/10GBASE-T1和SerDes链路协议，分别适配当下超高频高速的车载以太网和超高清屏幕连接。该产品涵盖90°、180°和屏蔽、非屏蔽版本，包括1~6位不同路数的连接器家族，且配备一次锁和二次锁和CPA（连接器位置保护）装置，线缆保持力高，并以多触点式设计达到优秀的EMC性能，确保在复杂的整车电磁环境中，高速信号依然传输稳定、不掉包。

罗森伯格(展位号:W2.505)新一代高压连接器HVR@25，在匹配4mm<sup>2</sup>铜线时可实现40A@85 的持续载流。其紧凑设计在同类产品中具有明显的体积优势，且拥有良好的性价比。它在确保满足40安培应用场景的安全规范与环境适应性前提下，通过优化冗余设计、提升装配效率等，实现了性能与成本的最佳平衡，为800V乃至更高电压系统提供了更具性价比的可靠方案。

历经二十载沉淀，慕尼黑上海电子展已超越单纯的专业展示与高效对接平台，成为全球半导体巨头与中国本土力量深度共生的关键节点。面对行业发展的迷雾与极致内卷，本届近1800家参展企业将用实实在在的技术落地案例证明：回归底层创新，才是穿越这轮周期的唯一路径。

展会将于2026年7月1-3日在上海新国际博览中心W1-W5、N1-N5举办！展会同期设立“2026(第四届)国际汽车电子技术创新论坛”以及“2026新能源汽车三电关键技术高峰论坛”等，诚邀您亲临现场，在不确定性中锚定技术基石，共同为中国

汽车产业的第二增长曲

线，注入坚实的底层动力！观众预登记通道已开启！点此可注册观展：<https://dwz.cn/B1uXgnu9>

原文地址：[http://www.china-nengyuan.com/exhibition/exhibition\\_news\\_246124.html](http://www.china-nengyuan.com/exhibition/exhibition_news_246124.html)